

高导热硅胶片芯片导热垫 柔软硅胶片

产品名称	高导热硅胶片芯片导热垫 柔软硅胶片
公司名称	深圳三一导热材料有限公司
价格	.00/片
规格参数	导热系数:2.0w/m-k 耐温范围:-40~220 耐电压:5KV/mm
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路茂源工业园B1栋2楼
联系电话	0755-29082440 13600411602

产品详情

产品详情

LC200高导热硅胶片是一款含有优质氢氧化铝粉填充复合物的导热材料。导热粉含量比重达到2.95g/cm³，更具优良的热传导性能，实验系数报告测试导热系数为2.0w/m.k。LG200常规颜色为蓝色，表面具有天然微粘性、柔软、良好的压缩性能，与元器件表面进行良好的贴合，大大减少了界面热阻。

LC200高导热硅胶片设计用于满足大功耗芯片降低工作温度的导热与稳定作用，具有高可靠性，良好的电气绝缘特性，满足UL94V-0阻燃等级要求。

特点优势

低热阻，高性价比。

可压缩性强，柔软兼有弹性。

高导热率。

天然粘性，无需额外表面粘合。

满足ROHS及UL的环境要求。

典型应用

笔记本、手机、平板

微处理器、图形处理器

通讯设备

储存模块、芯片级封装

汽车发动机控制模块

基本规格

多种厚度 (0.3,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0MM)

片材 (200*400MM,300*300MM,300*400MM)

定制模切

可背胶

物理特性参数表：

测试项目	测试方法	单位	LC200测试值
颜色 Color	Visual		蓝色
厚度 Thickness	ASTM D374	Mm	0.3~5
比重 Specific Gravity	ASTM D792	g/cm3	
			2.95 ± 0.1
硬度 Hardness	ASTM D2240	Shore C	
			15 ± 5~30 ± 5
抗拉强度 Tensile Strength	ASTM D412	kg/cm2	8
	ASTM D412	Pa	5.88*109
耐温范围 Continuous use Temp	EN344		-40~+220
体积电阻 Volume Resistivity	ASTM D257	-cm	
			3.1*1011
耐电压 Voltage Endurance	ASTM D149	KV/mm	5
阻燃性 Flame Rating	UL-94		V-0
导热系数 Conductivity	ASTM D5470	w/m-k	2.0
符合REACH 规范 符合RoHS 规范 符合UL 规范			